

トレックス・セミコンダクター株式会社
品質保証部

成分表

製品名(鉛フリー): XC6118xxxA/BMR-G
標準質量: 16 mg

名称	質量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CAS No.
シリコンチップ	0.197	シリコン	12300	7440-21-3
		- 砒素	<1	7440-38-2
リードフレーム	5.503	銅	343900	7440-50-8
		錫	1400	7440-31-5
		亜鉛	1300	7440-66-6
		クロム	1500	7440-47-3
		銀	20300	7440-22-4
ダイアタッチ	0.049	銀	3100	7440-22-4
		エポキシ	600	—
ボンディングワイヤ	0.050	金	3100	7440-57-5
封止樹脂	7.680	溶融シリカ	480000	60676-86-0
		エポキシ樹脂	45600	—
		フェノール樹脂	38400	—
		金属水酸化物	27300	—
端子メッキ	0.340	錫	21300	7440-31-5

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 質量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせていただきます。